

2006年3月期 第1四半期 事業説明会（2005年8月4日実施）

スライド 1～ 代表取締役社長兼COO 川村 誠スピーチ

スライド13～ 執行役員 移動体通信機器事業本部長 山本 康行スピーチ

スライド23～ 執行役員常務 電子部品事業本部長 野元 修スピーチ

スライド28～ 代表取締役会長兼CEO 西口 泰夫スピーチ

スライド42～ 執行役員 通信システム機器事業本部長 神野 純一スピーチ

スライド51～ 京セラS L Cテクノロジー株式会社社長 前 耕司スピーチ

代表取締役社長兼COO 川村 誠スピーチ

<スライド1：将来予想に関する注意事項>

本日当社からご説明いたします内容につきましては、こちらのスライドにあります「将来予想に関する注意事項」にご留意願います。

<スライド2：2006年3月期第1四半期連結業績ハイライト>

当期第1四半期のエレクトロニクス機器市場は、昨年夏以降、低迷を続けていた生産活動が緩やかな回復となり、その結果、部品需要も徐々に拡大傾向となりました。しかし、前期第1四半期の旺盛な部品需要に比べますと、当期第1四半期の部品需要は低調に推移しました。また、部品価格につきましても、一般電子部品を例にとりますと、前年同期に比較して15%程度の下落となるなど、厳しい市場環境となりました。

このような市場環境を受け、当期第1四半期の連結業績は、スライドに示しますように前年同期と比較し減収減益となりました。

当期第1四半期のフリーキャッシュフローは147億円のマイナスとなりました。当期純利益が86億円にとどまる一方で、有機パッケージやソーラーエネルギーをはじめとする事業へ積極的な投資を実施し、270億円の設備投資額となりましたこと、さらに、前期期末配当金を1株当たり20円増配し、95億円の配当を支払ったことによるものです。

研究開発費は145億円で、前年同期に比較し4.2%増加いたしました。情報

機器関連事業におけるカラー製品の開発費用等が主な増加要因です。

当期第1四半期の平均為替レートは、米ドルが108円、ユーロが136円でありましたので、前年同期に比べ、米ドルで2円の円高、ユーロは4円の円安となりました。為替レートの変動による影響額であります。連結売上高に対しては、米ドルに対する円高の影響がユーロに対する円安効果を上回ったことにより、前年同期に比べ約4億円のデメリットとなりました。一方、税引前当期純利益は、ユーロに対する円安効果により、前年同期に比べ約5億円のプラス要因となりました。

<スライド3：2006年3月期第1四半期市場環境と経営成果>

このスライドは、当期第1四半期の市場環境と経営成果をまとめたものであります。市場環境につきましては、先ほどご説明申し上げたとおりです。

当期第1四半期の経営成果としまして、3点をこちらに示しております。まず1点目として、ソーラーエネルギー事業などが好調であり、「ファインセラミック応用品関連事業」が期初の予定を上回って終了いたしました。

2点目といたしまして、本年5月に公表いたしました米国子会社KWCの事業構造改革を実施し、端末の生産委託を進めております。

3点目は、グローバル連結経営を強化するため、本年6月より、西口をCEO、梅村をCFO、私をCOOとする新しい執行役員体制をスタートさせました。また、事業本部制を導入し、各事業本部長は、国内海外を含むプロダクトラインのグローバルな連結経営に全責任を負う体制といたしました。

<スライド4：2006年3月期第1四半期の状況>

当社は、四半期別の業績予想を公表しておりませんが、期初時点での計画と比べますと、当期第1四半期は、やや厳しい結果で終了いたしました。その要因は、次の3点に集約されます。

まず、KWCの損失が拡大したことであります。当期第1四半期は、既存モデルの販売が中心となり、KWCの売上は計画を下回り、損失が拡大しました。しかし、KWCは、7月より当社グループで開発したモデルに加え、ODMモデルを含めた新モデルを投入しており、第2四半期だけでも6モデルを順次投入する計画であり、第2四半期以降、売上増が図れるものと考えております。

さらに本年9月には、端末の生産をフレクストロニクス社に全て移管する予定であり、第2四半期も損失は残る見通しであります。第3四半期以降は黒字化し、通期ではブレークイーブンを達成してまいります。

2つ目は、デジタルコンシューマ機器向けの部品需要の回復が弱く、部品価格が想定以上に下落した影響です。これにより京セラ単独の電子部品や、コネクタの売上が低迷しました。また、デジタルカメラ市場が伸び悩んだことにより、水晶関連部品の利益も予定を下回ることとなりました。しかし、大手携帯電話端末メーカーの生産は、第2四半期以降回復に転じると予想しており、これに伴い、当社の部品需要も増加する見通しであります。また、部品需要の拡大により、価格下落も鈍化するものと見込んでおります。

3つ目は、中国でのPHS関連事業の低迷が継続したことであります。昨年の夏以降、中国市場の低迷は想定以上に長引いておりますが、受注に関しましては、第1四半期は期初の計画を上回って推移しており、売上は第2四半期以降、増加に転じるものと考えております。また、当期第1四半期においては、保有するPHS関連製品の部材を中心として、評価減を実施したことも利益を悪化させる要因となりました。

以上3つの要因につきましては、第2四半期以降は改善されるものと確信しております。

<スライド5：2006年3月期第1四半期事業セグメント別連結売上高>

このスライドは、当期第1四半期の事業セグメント別の売上高でございます。当社は従来、事業セグメントを、「ファインセラミック関連事業」、「電子デバイス関連事業」、「機器関連事業」並びに「その他の事業」の4つに区分してご報告しておりました。しかし、各事業の規模の変化を考慮し、また、事業内容をより一層明確にしたセグメント別の経営及び管理を行っていくとことに加え、さらにディスクロージャーの向上を図るため、当期よりこちらの8つの事業セグメントに変更しております。

中段にあります部品事業の売上高は、「ファインセラミック応用品関連事業」を除き、前年同期と比べ、減収となりました。

また、機器事業におきましては、「情報機器関連事業」は欧州、米国で販売を伸ばし、前年同期と比べ増収となりました。しかし、「通信機器関連事業」が減収

となり、「光学機器関連事業」の売上も、事業構造改革によりカメラ事業を大幅に縮小したため、減収となりました。

「その他の事業」につきましては、京セラコミュニケーションシステム(株)の伸びにより、前年同期と比べ増収となりました。

<スライド6：2006年3月期第1四半期事業セグメント別連結事業利益>

続きまして、セグメント別の事業利益についてご説明申し上げます。

部品事業につきましては、減収及び部品価格の下落が影響し、「ファインセラミック応用品関連事業」を除いて、前年同期に比べ減益となりました。

機器事業につきましては、「通信機器関連事業」では、KWCと海外向けのPHS関連製品の減収を主因として減益となりました。「情報機器関連事業」では、製品価格の下落の影響や、下半期に投入を予定しておりますカラー複合機やカラープリンタの開発費用の増加により減益となりました。しかし、「光学機器関連事業」では、カメラ事業の縮小による構造改革の成果が現れ、損失が減少しました。

「その他の事業」につきましては、京セラケミカルの減収等の影響により、前年同期に比べ減益となりました。

<スライド7：2006年3月期連結業績予想>

当期の連結業績予想につきましては、中ほどにあります1株当たり当期純利益と、一番下にあります平均為替レートを除き、期初に公表しました売上、利益の予想から変更はございません。

売上高は、前期比5.0%の増収となる、1兆2,400億円を予想しております。また、利益につきましては、営業利益は、前期比22.8%増益の1,240億円、税引前当期純利益は、前期比25.5%増益の1,350億円、当期純利益は、前期比76.4%増益の810億円を予想しております。

続きまして、連結業績予想の前提条件についてご説明申し上げます。

<スライド8：2006年3月期連結業績予想の前提条件>

主な電子機器の出荷台数見通し及び部品価格の見通しは期初予想から変更はありません。

為替レートにつきましては、第1四半期の為替レートの実績を考慮し、また第2四半期以降の予想レートを見直し、通期の為替レートを1ドル106円、1ユーロ129円へと変更いたしました。

なお、前期と比較しますと、為替レートの変動により、売上高、税引前利益に対し、それぞれ164億円、60億円のデメリットが生じるものと見込んでおります。

<スライド9：主要電子機器出荷台数見通し及び部品価格見通し>

2005年暦年の主要電子機器の出荷台数見通しにつきましては、このスライドに示しておりますとおり、前年に比較し、堅調な伸びを見込んでおります。

また、部品価格につきましては、前期比で年間10 - 15%程度の下落を予想しております。第2四半期以降、部品需要の拡大に伴い、価格の下落幅は緩やかになると予想しております。

<スライド10：2006年3月期事業セグメント別売上高・税引前利益>

このスライドは、各事業セグメントの売上、税引前利益の通期予想であります。各セグメントにおいても、期初予想からの変更はありません。

上段が売上高、下段が税引前利益を示しています。

売上高は、グループ全体で前期比593億円の増加を予想しておりますが、そのうち部品事業で374億円、機器事業で72億円の増加を見込んでおります。部品事業においては、特に「ファインセラミック応用品関連事業」の増加を、機器事業においては「通信機器関連事業」の増加を予想しております。

下段の税引前利益については、グループ全体で前期比275億円の増益を予想しておりますが、部品事業では5億円の減益を見込んでおり、機器事業が291億円の大幅な増益予想となっています。特に、前期に大きな赤字を計上しました「通信機器」と、「光学機器」の利益が、大幅に改善する見通しでございます。

<スライド11：京セラグループ経営方針>

私の説明の最後に、京セラグループが目指す、“さらに成長し続ける創造型企業”の実現に向けて、今後の私の経営方針について簡単に申し上げます。

1つ目は顧客満足度の追求であります。お客様のニーズをいち早く捉え、それらを製品化することに加え、事業の基本ではございますが、品質、価格、納期、サービスのさらなる向上を徹底して追求してまいります。

2つ目はグローバル化の進展です。需要のあるところで事業を行うのが、当社の事業展開の基本姿勢であり、将来の市場成長を見据えた、開発、製造、販売面での一層のグローバル化を進めてまいります。

3つ目は高収益企業の実現であります。株主及びすべてのステークホルダーの利益を拡大させ、ひいては社会の発展に寄与するために、京セラグループは高収益であり続けなければならないと考え、その実現に努めてまいります。

4つ目は企業文化の維持と発展でございます。企業文化の中心をなす企業哲学を共有し、さらに発展させることが、企業成長のベースになると考えております。京セラグループに脈々と受け継がれているフィロソフィの継承を積極的に図ってまいります。

これら4つの方針に基づき、京セラグループの経営を行い、まずは、今期の業績予想である、連結売上高1兆2,400億円、連結税引前利益1,350億円、税引前利益率10.9%の達成を目指してまいります。

<スライド12：2006年3月期経営課題>

引き続き、今期、通期の業績予想を達成するための経営課題である2つの事業について、それぞれ担当よりご説明いたします。

執行役員 移動体通信機器事業本部長 山本 康行スピーチ

<スライド13：通信機器関連事業の収益改善>

移動体通信機器事業本部の山本でございます。平素は皆様にはたいへんお世話になり、厚くお礼申し上げます。それでは、今期の通信機器関連事業の収益改善につきまして、私より説明させていただきます。

今期通期の「通信機器関連事業」の事業利益は、70億円を予想しております。当期第1四半期は64億円の赤字で終了しており、通期予想を達成するためには、第2四半期以降に大幅な改善が必要となります。

この利益改善を実現するために、KWC、国内の移動体通信機器、PHS関連製

品のそれぞれの事業において、こちらのスライドに示した取り組みを進めてまいります。本日は、私より、特にKWCの収益改善策について説明させていただきます。

<スライド14：KWCの収益向上（1）>

KWCの課題は、大きくこの2つであります。1つは、抜本的にコスト構造を改革し、人件費を中心とした固定費を削減し、損益分岐点を引き下げること、もう1つは、売上の拡大を図るため、継続的かつタイムリーに新商品を投入することです。

この2つの課題克服のため、KWCは、新たな事業体制を確立しました。

<スライド15：KWCの収益向上（2） - 新たな事業体制の確立 >

新たな事業体制について、具体的にご説明申し上げます。

KWCは、北米市場を中心に、年間1,000万台以上の端末を販売しておりますが、さらに販売を拡大させるためには、コンスタントに多くの商品をタイムリーに投入していく必要があると考えております。そのためには、開発力を強化することがきわめて重要であり、今回、新たなグループの開発体制を構築し、開発のスピードアップと効率化を進めてまいります。

まず、インドの子会社であるKWIが端末のソフトウェア開発を全面的に担う体制としました。そして、主に、米国の研究開発拠点であるKTRCにてキーデバイス、コア技術の開発を行い、これを基に、KWC及び京セラが、次世代モデルの新規開発、製品化を行うこととなります。

また、この次世代モデルをベースとしたコスト競争力を強化した普及モデルの開発、製品化を、KWIやフレクストロニクス社、アジアのODMメーカーが行う体制といたします。

製造については、本年9月を目処にフレクストロニクス社に全面移管し、コストの削減を合わせて実現してまいります。

<スライド16：KWCの収益向上（3）アジアへのシフトによる事業構造の改革>

今後KWCは、製造・開発・サプライチェーンの拠点をアジアへシフトしてまいります。これにより、製造及び開発コストの低減と、タイムリーな製品投入を図

ってまいります。

<スライド17：KWCの収益向上（4） - 損益分岐点の引き下げ - >

こちらのスライドは、上段に端末台数をベースにした損益分岐点の推移を、下段に製造移管スケジュールを示しています。サンディエゴからメキシコへ製造移管を実施しました前期末を100としますと、フレクストロニクス社への移管終了を予定しています。当期上期末には、2割弱ではありますが、着実に損益分岐点の引き下げが可能と考えております。さらに一層のコスト構造改革を実施し、当面の目標として、本年3月末に比較し3割強の引き下げに努めてまいります。

また、製造移管による製造原価の削減に加えまして、抜本的なコスト構造改革策として、固定費の変動費化を引き続き進めてまいります。

具体的には、昨年9月末に約2,500名であったサンディエゴの従業員数を、本年9月までに40%以上減少させ、さらなる削減も検討してまいります。

<スライド18：KWCの収益向上（5） - 開発力強化 - >

また、京セラグループの端末のソフトウェア開発を一手に引き受けますKWIについては、顧客ニーズにあった商品投入を継続的に実現するため、開発体制の強化を図っています。KWIは、設立以来、積極的な採用を実施しており、本年6月には、従業員数は300名を超えています。

当社は、今後も、ソフトウェアを中心とした強化すべき点に対しまして、積極的な投資を継続していく予定であります。

<スライド19：KWCの収益向上（6） - 製品ロードマップ - >

開発体制の強化などの新たな事業体制の構築により、本年7月以降、こちらに示しておりますように、多くの製品を市場投入してまいります。クリスマス商戦に向けて、ローエンドからハイエンドまでにわたる新モデルの投入を行う予定であります。

<スライド20：KWCの収益向上（7） - 新商品の積極的投入 - >

製品投入の戦略として、2つのパターンが考えられます。1つは既存モデルのシリーズ化により開発コストを縮小し、利益を得るという戦略と、もう1つは、新

商品をタイムリーに投入することで、プロダクトミックスを改善し、ASP（平均単価）の維持に努め、利益を得るという戦略です。

KWCは、当期第1四半期においては新商品を投入できませんでしたが、先ほど申し上げました事業体制とロードマップに沿って、こちらのグラフに示しますとおり、第2四半期には新商品比率を35%へと拡大させ、第4四半期には80%を超える比率を目指してまいります。

<スライド21：KWCの収益向上（8） - 新商品投入による売上拡大 - >

ただ今申し上げましたように、新商品の積極的な市場投入によるラインアップの拡充により、こちらのグラフにございますとおり、KWCの出荷台数は、当期第1四半期を100としますと、第2四半期は34%増、クリスマス商戦シーズンの第3四半期には、2倍以上を想定しております。また、季節要因により需要が低迷する第4四半期についても、第2四半期並みの出荷数量を見込んでおり、コスト構造の改革の効果により、利益を計上できると考えております。

以上の取り組みを進めることによりまして、KWCの収益性の改善を早急に進め、下半期以降は継続して利益を出すことができるような体制へと変革を図ってまいります。

<スライド22：通信機器関連事業の収益改善>

次に、国内の携帯電話端末事業についてであります。国内では、タイムリーな新商品の投入により、KDDIグループでのシェアアップを最重点課題としてまいります。具体的には、KDDIにおける20%のシェア獲得を目標としています。また、国内においても一部ODMを活用し、商品ラインアップを拡充してまいります。

最後にPHS関連製品ですが、現在オーストラリアと南アフリカの2カ国で商用サービスが行われているiBurst[™]のさらなる市場開拓を進めてまいります。また、国内においては、(株)ウィルコムが通話定額サービスを導入し、現在順調に新規加入者を増やしています。当社のブラウザホンも好調な出荷を続けており、下半期には、より高速のデータ通信サービスに対応した新商品を投入することにより、事業拡大を図ってまいります。PHS関連事業の戦略につきましては、後ほど神野事業本部長より説明いただきます。

執行役員常務 電子部品事業本部長 野元 修スピーチ

<スライド23：電子デバイス関連事業の利益率向上>

当社グループで共有している経営の原則に、「売上最大、経費最小」という考えがあります。経営の基本とは実は非常にシンプルで、売上をいかに拡大させ、かつ経費をいかに抑制させ、利益の最大化を追求するかという考えでございます。電子デバイス関連事業におきましては、売上を最大にするための施策として、「製品ラインアップの拡充とシェアアップ」、及び「新市場開拓」を図ってまいります。

製品ラインアップの拡充につきましては、具体的には、高付加価値のコンデンサや水晶関連部品の投入を行ってまいります。また、小型大容量コンデンサ等の新製品開発も進めてまいります。

新市場開拓の具体的内容としましては、成長著しいアジア市場における客先開拓を行うとともに、高周波モジュールの応用展開及び、サーマルプリンヘッドやコンデンサにおける用途拡大を図ります。

経費の最小化につきましては、生産性の向上を中心に取り組んでまいります。具体的には、中国拠点での生産拡大を図り、セラミックコンデンサ、LEDをはじめとする主要部品において、中国生産をさらに進めてまいります。

また、新生産システムの拡大として、これまで取り組んでまいりました歩留まり100%を目指す生産システムの構築を、コンデンサ、水晶関連部品で展開し、利益率向上を図ってまいります。

第1四半期は既存部品の価格低下が想定より厳しく、減収により収益性を低下させました。部品価格の下落を、新商品の売上増でカバーできる事業構造にすることが重要な課題と認識しております。

これより、受動部品の代表的な製品でありますコンデンサ、水晶関連部品、そして、機能をもたせたモジュール製品について、それぞれ新製品開発の考え方と方向性についてご説明申し上げます。

<スライド24：デジタル電子機器動向とセラミックコンデンサの開発方向>

まず、京セラのコンデンサについてです。

このスライドは、デジタル電子機器の今後の動向とそれらの機器に要求されますコンデンサの特性を示しております。縦軸に情報の処理速度、横軸に機器のモビ

リティ性を示しております。機器の高速データ処理のためには低電圧、大電流化、高周波化が更に進んでいきます。これらの回路に要求されます大容量コンデンサ、及び低インダクタンスコンデンサの商品化を進めていきます。

モビリティ性向上の為に、あらゆる機器におきましてワイヤレス化、小型化が更に進んでまいります。

当社はこれらの要求に応える為に、超小型のコンデンサの商品化を進めてまいります。

ここでキーとなる技術は、高積層化技術、薄層化技術、高精度化技術、高速積層技術になります。今後の大容量化、超小型化については、これら技術の高度化を図ることに加え、生産性向上に寄与する新たな工法による生産を拡大させ、収益性の向上を図っていく考えであります。

<スライド25：2006年3月期セラミックコンデンサ新商品の受注計画>

このスライドは、京セラ単独のセラミックコンデンサ事業において、過去2年以内に市場投入した新製品の四半期別の受注計画について、当期第1四半期実績を100として示しております。第2四半期以降は新商品投入により、第4四半期にはほぼ倍となる受注を計画しております。なお、今期の新商品比率は、通期の受注金額の約20%を目指しております。

<スライド26：主要な水晶関連部品のロードマップ>

このスライドは、水晶関連部品の代表的な商品ロードマップを示しています。上段が現在量産しております製品であり、下の2ラインが新製品のロードマップであります。

上段の量産商品の中で、黄色で示しますのは携帯電話用TCXOであり、白色で示しますものは民生用振動子のロードマップであります。

携帯電話用TCXOにおいては、3.2 x 2.5 mm製品のGPS市場への拡販及びその小型化を図り、今年度中に2.5 x 2.0 mm製品の投入を図ってまいります。

また、白色で示します民生用振動子についても、同様にダウンサイズ化を図り、今年度中に更なる小型製品(2.0 x 1.6 mm)の投入を行い、拡販を行ってまいります。

また、新製品としては、地上波デジタルモバイル放送用 S A W デバイス及び無線 L A N 対応用のデジタル携帯端末に用いられる超高周波デバイス(圧電薄膜技術の応用)の投入を本年中に行い、事業拡大を目指してまいります。

<スライド 27：高周波モジュールのロードマップ>

このスライドは、当社のモジュールのロードマップです。上段がモバイル端末の今後トレンド、中段が当社の製品展開、下段がモジュール構造のトレンドを示しています。

モジュールにつきましては、今後、高周波モジュールの分野、特にモバイル用途の製品に力を入れて参ります。現在、モバイル分野は携帯電話、P D A、ゲームといった製品を中心に大きく進化し、高機能化が進んでおります。その中で、京セラは、特に携帯電話市場へのモジュール製品群の積極的な展開を目指してまいります。

一例をあげますと、中段にあります B l u e t o o t h モジュールにつきましては、超小型モジュールを市場投入することで、シェアを伸ばしてきております。特に、今期下期には、大手携帯電話メーカーからの B l u e t o o t h モジュールの受注獲得により、ビジネスの拡大期に入っていくものと考えております。携帯電話には、B l u e t o o t h 以外にも、W L A N (ワイヤレスラン)、H D D (ハードディスク)、G P S などの機能が今後付加されて参ります。そうしたニーズに対応した製品開発を進めてまいります。

京セラは、セラミック材料から、それらを使用した各種電子部品、基板材料、コネクタ等のモジュール開発の要素技術を多数保有しております。また、部品事業だけでなく、携帯電話自身のメーカーでもあり、ユーザー側に立った要求をいち早く部品要求に反映させ、新商品の市場投入に活かしてまいります。

本日は、当社グループの一部の製品展開についてご説明申し上げましたが、A V X との開発、製造、販売面での協業を推進し、さらにグループシナジーを追求してまいりたいと考えます。

代表取締役会長兼CEO 西口 泰夫スピーチ

<スライド28：京セラグループの中長期戦略>

私自身、これまで何度かこうした説明会の場で、皆様にお話させていただいてまいりましたが、京セラグループは、“21世紀にさらに成長し続ける創造型企業”を目指しております。

経営環境の変化にかかわらず、京セラグループが安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、高い収益性を持った核となる事業を複数持つことが重要であるとの考えから、私は、それぞれの事業が税引前利益率で15%以上を達成する「価値ある事業」となることを目標としていることも、既にお話させて頂いている通りであります。

しかし残念ながら、京セラグループの経営は、まだまだ安定的に成長を続けることのできる状態にはありません。事業によって収益性にばらつきがあり、市場環境の状況に大きく左右されているのが現状であります。当社グループが目指しています「価値ある事業の多角化」をできるだけ短い期間で実現させるためにも、本年6月よりスタートさせました新たな経営体制のもと、この目標の達成を目指してまいります。

<スライド29：新たな経営体制の確立>

京セラグループは、本年6月1日より、新たにCEO、CFO、COOを設けました。

私はCEOとして、グループ全体の中長期の経営方針、経営戦略を策定し、これを実行するリーダーシップをとってまいります。

また、CFOの梅村は、グループの経営戦略を支えるための財務戦略を策定し、実行してまいります。COOの川村は、グループの毎年の経営計画達成のための業務執行を担当します。私は新たにCEOという立場から、CFOとCOO、さらに各事業本部長と協力して、業務遂行にあたることにより、「価値ある事業」の多角化の実現を目指してまいりたいと思います。

それでは、少しお時間をいただいて、京セラグループの事業ポートフォリオの現状と、それぞれの事業の価値を向上させていく戦略について、ご説明させていただきます。

<スライド30：京セラグループの事業ポートフォリオ（1）>

このスライドは、今後の当社グループの発展を支えると考えます戦略事業について、縦軸に今後の中期的な市場成長率をとり、横軸にグローバルシェアをとった図でございます。市場成長率は、暦年の2004年から2006年の日本の実質GDP成長率の実績、予想の平均である2%を基準として、これを下回る市場成長率を「低い」事業とし、5%以上を「高い」事業と区分しています。

横軸のグローバルシェアは、ワールドワイドでシェア3位以内であれば、「高い」、4位から6位であれば「中」、7位以下もしくは新規参入については「低い」と区分しております。

このような観点から、現在の当社グループの主な事業をマッピングしますと、大体このスライドに示したようになります。

ご覧いただいておりますように、当社グループの戦略事業は、2%以上の市場成長率が予想される領域に入っており、これらは現在の当社グループの売上高の約80%を占めております。

市場成長率の低い事業は、例えば、カメラ事業のように、事業からの撤退も実施しております。今後もそのような事業については選択と集中を実行してまいりたいと考えます。

次に、それぞれの領域における当社グループの今後の事業戦略について説明させていただきます。

<スライド31：京セラグループの事業ポートフォリオ（2）>

まず、右上にあります、市場成長率が高く、グローバルシェアも高い事業の戦略についてご説明したいと思っております。

この領域には、ファインセラミック部品、セラミックパッケージ、ソーラーセル・モジュール、PHS関連製品、光通信用部品が入っております。

この領域の事業につきましては、高いマーケットシェアを維持しつつ、かつ利益率の向上を追求していくことが基本的な事業戦略となります。そのために、技術力、商品力の向上を目的とした、積極的な研究開発投資を行ってまいります。

この領域の具体的な事例として、後ほど神野よりPHS関連製品についてご説明をさせていただきたいと思っております。

<スライド32：京セラグループの事業ポートフォリオ（3）>

続きまして、市場成長率は5%以下であるものの、高いグローバルシェアを有する事業の戦略について申し上げます。

現在の当社グループの事業においては、水晶関連製品やサーマルプリントヘッドがこれにあたります。

この領域の事業につきましては、利益率を維持・向上させるための投資を行い、事業の運営にあたっては投資効率を重視してまいりたいと考えます。

<スライド33：サーマルプリントヘッド事業戦略>

サーマルプリントヘッド事業を例に挙げ、ご説明させていただきたいと思えます。

サーマルプリントヘッドは、前期2005年3月期の実績で、売上高は約200億円と、単一の部品事業としては大きな売上規模となっております。また、当社が20年以上にわたりトップシェアを有する製品でございます。

この事業では、特に中国への後工程の生産移管を進め、利益率の向上を図ってまいります。

また、前工程の歩留まりを向上させるため、生産技術開発センターを活用した、生産性の向上を追求してまいりたいと考えております。

サーマルプリントヘッドは、以前は感熱紙タイプのFAXが主要な用途でありましたが、現在はバーコードプリンタや、カード用プリンタ、デジタルフォトプリンタ等、用途を多彩に拡げ、他社に先駆けて新市場を開拓することによって新たな利益の源泉を獲得してまいりました。

この領域では、今後も既存製品の用途拡大により、少ない投資で利益を着実に得る、高い投資効率を追求してまいりたいと考えております。

<スライド34：京セラグループの事業ポートフォリオ（4）>

次に、市場成長率が高いものの、当社シェアは中位に属するという領域についてご説明いたします。これに該当する製品は、昨年立ち上げました高画素カメラモジュールや、自動車部品並びにCDMA端末等の事業でございます。

この領域では、市場でその事業のリーダーとなることを目標に、積極的に事業拡大を進めるとともに、収益性を重視しながらシェアを拡大することを事業戦略としております。

<スライド35：自動車部品事業戦略>

この領域での事業例として、自動車部品の事業戦略について説明いたします。自動車市場に対しては、今後の潜在的な市場成長率を見据え、数年前にプロジェクトチームを設置いたしました。セラミックエンジン部品やセラミックヒーター等、それまで個々の製品で自動車市場に展開しておりましたが、社内の技術資源を横断的にまとめ、当社グループの材料、部品からデバイス、機器にわたる幅広い技術力と製品力を統合することにより、自動車関連部品を総合的に事業拡大できるよう展開しております。

また、収益性を重視し、高付加価値製品の開発に集中しております。特に、当社が得意としますセラミック技術を活用し、今後の新市場創造のキーワードである、自動車の環境対応化という課題を解決する製品の拡販に努めております。

具体的には、欧州で普及していますディーゼル車市場に重点をおきまして、ディーゼルエンジンにおける排気ガス中の有害物質を削減するため、燃料の高圧噴射を可能とし、かつ燃料の噴射量もより精密にコントロールすることができるディーゼルエンジン用のアクチュエーターや、ディーゼルエンジンの始動時に白煙を効果的に低減できます小型で低消費電力のセラミックグロープラグ等の製品の拡販に努めております。

地球規模で環境問題が重視されるなか、ディーゼルエンジンの普及率の低い国々でも、今後その普及率が上昇するものと見込まれておりまして、今後高い売上成長を期待しております。

さらに、シェア拡大を図るため、中国を重点市場のひとつとして捉え、生産・販売拠点の構築を早急に進めたいと考えております。

<スライド36：京セラグループの事業ポートフォリオ（5）>

続きまして、高い市場成長率が見込まれるものの、現在のシェアは低い事業、もしくは新たに立ち上げる事業の戦略について、ご説明申し上げます。

この領域には、有機パッケージ、カラー複合機やカラープリンタ、医療用及び歯科用材料、有機ELディスプレイ、燃料電池等が含まれております。

これらの事業については、市場シェアの獲得を最優先とし、外部の経営資源の活用も含めた積極的な事業投資を行ってまいります。また、短期的な利益率の低迷は容認し、市場獲得のためのシェア拡大を優先してまいります。

この領域に属する事業例としましては、後ほど京セラ S L C テクノロジー（株）の前より、有機パッケージ事業について、ご説明させていただきます。

<スライド 37：京セラグループの事業ポートフォリオ（6）>

最後の領域は、市場成長率が年率 5 % 以下で、シェアがトップ 3 には届いていない事業群でございます。

ここでは、早急なシェア拡大と利益率向上の両方を追求して参りたいと思います。また、シェア拡大のための事業投資を実施してまいりたいと考えております。グローバルシェアに差はありますが、切削工具や、コネクタ、セラミックコンデンサ、モノクロ複合機やプリンタ、産業用 S T N 液晶等がこの領域に入ります。切削工具事業を例に挙げ、ご説明させていただきます。

<スライド 38：切削工具事業戦略>

切削工具事業につきましては、シェア拡大と利益率の向上を図るため、材料技術を用いた幅広い製品開発に注力してまいります。

そして、重点市場として中国を中心とするアジア市場をターゲットとし、同地域での製造拠点及び販売拠点を強化してまいります。

また、供給力拡大とコスト削減の観点では、今期、材料からグループ内で一貫して生産する新たな生産ラインへの投資を実施してまいります。

さらに、一層のコスト削減を図り、グローバル生産ネットワークの構築や S C M（サプライ・チェーン・マネジメント）の活用を行って参りたいと考えております。

I T 関連市場での事業を拡大するため、マイクロドリルの子会社である京セラタイコムとのシナジー追求も行ってまいります。

<スライド 39：京セラグループの事業ポートフォリオ（7）>

当期は、このスライドに、赤い丸で囲んだ事業について、超合理化と生産性向上を目指した新たな生産ラインの導入等、積極的な設備投資を実施いたします。

これらの事業を中心に、当期は 1 , 0 0 0 億円の設備投資を計画しています。

<スライド40：2006年3月期戦略的設備投資内容>

現在これらの設備投資は、いずれも予定通り進行しています。高い生産性を追求した一貫生産ライン、超合理化生産ラインの構築により、当社グループのモノづくりの生産性を強化したいと考えております。

今期は、これらの投資を実施することによりまして、前期2005年3月期に比較しまして約60億円の利益に対するマイナス要因が発生することとなります。しかし、これらの事業は、3年後の2008年3月期には、前期に対しまして税引前利益で150億円程度の増益をもたらすものと見込んでおります。

<スライド41：京セラグループの中長期戦略>

私は本年6月よりCEOという新たな立場でグループの運営を任されることとなりました。約8万5千名の株主の皆様、ステークホルダーの皆様の利益を増大させるためにも、京セラグループのさらなる成長を図っていかねばならないと強く感じております。

「価値ある事業の多角化」により、京セラグループがさらに成長し続ける企業となるため、新たな視点から経営を行い、現時点で課題となっております税引前利益率15%以上の達成に邁進してまいりたいと考えております。

引き続き、皆様におかれましては、当社グループに対し、ご指導ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上で私からの説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。

執行役員 通信システム機器事業本部長 神野 純一スピーチ

<スライド42：通信システム機器事業の変遷>

皆様、ご覧のスライドの上段には、PHSの国内、海外市場について、次いで、中段には、WLLシステム、EVDO基地局を、そして、下段には、iBurst[™]システムに分類して、年代と共に、その変遷を示してあります。

当事業本部発足のきっかけは、旧DDIポケット、つまり、現在のWILLCOM様向けのPHS基地局や端末製品の事業化に始まります。更に、この経験を活かし、中国、台湾へと海外進出を果たす事となります。

次に、PHSプロトコルをベースに、WLLシステムを立ち上げ、フィリピン、

U A E、エチオピア、そして、タイ・トルの大型案件を手掛ける事が出来ました。そして現在、ワイヤレス・ブロードバンドと言うニーズの高まりを一早く捉え、i B u r s t ™ システムの実用化に取り組んで参りました。

本日は、国内・W I L L C O M 様向け、並びに、中国市場向けの P H S の動向、そして i B u r s t ™ システムに焦点を絞って、順次、ご説明申し上げます。

<スライド43：国内P H S 市場への取り組み>

御覧のスライドには、国内・W I L L C O M 様向けの製品ラインナップの変遷を、表示させて頂いております。

端末の欄に有ります A H K 3 0 0 1 V は、昨年5月の発売以来、「京ポン」の愛称で御愛顧を賜り、現在も好調に推移しております。この端末の登場により、従来の携帯電話のビジネスモデルにまで、影響を及ぼす事となりました。なお現在、更にパワーアップした後継機種の開発を、鋭意進めております

また、特定セグメントに的を絞ったコンセプトホンの分野では、P H S ならではの特長を活かした、キッズホン、ジャケットホン等、魅力溢れた、多彩な商品企画を推し進めております。

続いて、基地局関連でございますが、当社の特長でありますアダプティブ・アレイ・アンテナ技術をベースに、スライド右下に示します、高度化対応基地局の製品化を完了し、先月より出荷、設置工事を開始しております。

また同時に、次世代のP H S サービスを担う、システム・アーキテクチャーや要素技術の研究開発にも着手しております。

<スライド44：中国P H S 市場への取り組み>

このスライドでは、中国P H S 市場に対する、当社の取り組みについて、ご紹介させていただきます。

最初に、スライド上段でございますP H S エンジン戦略についてご説明致します。P H S エンジンとは、R F 部、ベースバンド部、そして客先毎にカスタマイズされたソフトウェア等、端末に必要な機能を1パッケージ化したモジュールを指します。当社は既に約2年にわたり、このP H S エンジン・ビジネスを継続し、累計でおよそ1,700万台の出荷実績を誇ります。

このエンジンを採用する現地の端末ベンダーでは、容易に多機種を開発できる事

から、大変重宝頂いております。

次にPHS基地局関連ですが、ご覧の主力機種を中心に展開しております。基地局の需要は、昨年来、月平均2千台前後と、低迷が続いております。但し、ここに来て、3Gライセンスの付与が遠のいた事により、若干、要求が増して来た様に思われます。

最後に、スライド右下のポケット通信の導入ですが、足掛け2年の歳月を経て、遂に、青島、泉州の両電信局での採用の目処が着きました。一旦動き出せば、急速に全土に拡大するものと期待しております。

<スライド45：中国PHS市場戦略>

ご覧のスライドは、当社の「中国PHS市場戦略」を図示したものです。

これまでの中国のPHSでは、音声通話を主体に、とにかく安価な端末が主流となっておりました。しかしながら、時代の進化と共に、ショートメッセージサービスが爆発的に普及しはじめ、PHS端末を通して情報のやり取りをする文化が、芽生えて参りました。つまり、データ通信を用いた各種付加サービスのニーズが、急速に高まりつつ有るのです。

当社は、この潮流に合わせて、ポケット対応エンジンや完成品端末、ポケット・サーバーや、ポケット専用基地局を取り揃え、図に示します様に、活発なマーケティング活動を展開して参ります。

この様に、今までの価格一辺倒の戦いから、付加価値の高い新製品戦略に転ずる事により、中国市場でのシェアの拡大、利益率の向上を図って参ります。

<スライド46：iBursttmシステム>

ここからは、ワイヤレス・ブロードバンドに対応した、iBursttmシステムについて、ご紹介させていただきます。

iBursttmシステムとは、スライドにその特長を示します通り、ハイ・データレートで、周波数利用効率が高く、IPネットワークに対応、勿論VoIPもサポート出来る、最先端の通信方式であります。

スライドの中央には、iBursttm基地局とUser Terminalの写真、その右隣には、設置風景をご覧頂く事が出来ます。

<スライド47：i B u r s t ™の特長～他方式との比較>

このスライドでは、i B u r s t ™システムのポジショニングに付いて表現しております。

縦軸には通信速度を、横軸にはシステムのカバーエリアを示して有ります。3 Gを代表とする携帯電話の場合には、カバーエリアは広範囲に渡りますが、ユーザー当たりの通信速度は、現状、決して高いとは言えません。逆に、高い通信速度を誇る無線LANの場合、カバーエリアの狭さが故に、公衆システムとしては受け入れられない難点が有ります。

i B u r s t ™システムは、正に両システムの境界線に位置し、夫々のシステムの長所を具備したものと言えます。

<スライド48：i B u r s t ™展開状況>

ご覧のスライドには、i B u r s t ™システムの世界展開状況を表しております。図の赤の部分は、既にi B u r s t ™システムの導入を決定した国々で、オーストラリアのP B A社、南アフリカのW B S社の2社がサービスインしております。更に、アゼルバイジャンのD a t a c e l l社、ガーナのI n f i n i t S t r e a m社の2社が、各々、開業に向けて準備を進めております。

また、図では水色で示して有ります、U K、アイルランド、レバノン、米国等で、現在もトライアルを進めており、我が国におきましても、昨年12月に実験用周波数の付与を受け、横浜地区にて実証実験を実施中でございます。

更に、地図上では黄色で示します、アフリカ諸国、ロシア、インド、東南アジア諸国など、世界各地より多くの商談を頂戴しております。通信インフラの構築には多額の資金が要求され、成約は決して容易ではございませんが、精一杯チャンスを活かして参ります。

<スライド49：i B u r s t ™展開状況～P B A , W B S >

このスライドでは、オーストラリアのP B A社、南アフリカのW B S社の概況について、ご紹介させていただきます。

P B A社では、シドニーを手始めに、既に豪州の主要4都市に、そのサービスエリアを拡大しております。開業当初は、都市部中心のエリア展開に留まっておりましたが、徐々に郊外へと拡張するに従い、加入者増に拍車が掛かり始めました。

特にデスクトップ・タイプの端末が増えて来た事から、無線版ADSLとしての用途が大きい事が伺えます。

南アフリカのWBS社の場合にも、概ね、同様の傾向が見られます。

<スライド50：通信システム機器事業の売上予想>

最後に、通信システム機器事業本部の「事業展開のまとめ」と致しまして、FY2005通期の実績に対する、今期FY2006の見通しに付きまして、グラフを用いてご説明させていただきます。

まず、国内PHS事業ですが、WILLCOM様の音声定額サービスの急速な普及に後押しされ、端末の需要が予想以上に旺盛で、高度化PHS基地局を加えますと、昨年比で大幅な売上増を見込んでおります。

逆に、中国PHS事業では、中央政府の政策変更の影響を受け易く、先行きの読み難い状況が続いております。特に、PHS基地局の大型受注には期待が薄い事から、PHSエンジンを中心とした、端末ビジネスに軸足を移した戦略を打ち出して参ります。先程も御紹介致しましたパケットサービスの普及が、次の発展への鍵となります。

最後にiBurst[™]システム事業で御座います。新規事業の立ち上げには時間を費やすのが常ですが、客先数が大幅に増加しておりますので、昨年比では増収の見込みです。iBurst[™]システムの場合、国内での周波数の獲得と、事業化の実現が、最も重要な決め手となります。

京セラS L Cテクノロジー株式会社社長 前 耕司スピーチ

<スライド51：マーケットドライバーの変遷と対応製品の事業展望>

有機事業として今まで、サーバー/ルーターや携帯機器市場を中心にビジネス拡大を図って参りました。

これらに加え、現在、光ブロードバンドを利用したユビキタスネットワーク市場においてゲーム機に代表されるデジタルエンタテインメント機器での事業展開を積極的に行っております。

このデジタルエンタテインメント機器で使用される高性能半導体には、高度な有機フリップチップパッケージが必要となります。

それでは有機パッケージの取り組みについて御説明させていただきます。

<スライド52：市場ニーズと戦略製品>

これは、マーケットドライバーとなる各種機器に対する市場ニーズと、戦略製品を表したものです。

縦軸を高速データ処理のニーズ、横軸を小型薄型化のニーズとした場合、デジタルエンタテインメント機器は膨大な画像の高速処理が、また携帯機器関連は、小型薄型が要求されています。

同時に、これらの機器には、いつでも、どこでも機器同士のデータのやり取りができるようなネットワーク機能が必要になってきており、いわゆるユビキタスネットワーク社会の到来と言えると考えております。

そこには各種機能を有する高性能半導体が中核部品として搭載され、私どものフリップチップパッケージ、SiP基板、マイクロカードなどが使用されてまいります。

<スライド53：有機パッケージの高度化がさらに進展>

これは、有機パッケージの高度化の進展を表したものです。

縦軸は、パッケージのビア密度をあらわし、横軸は配線ピッチをあらわしています。

パソコン用GPU、MPUに比較し、サーバー・ルーターなどに搭載される多ピンASIC用の中にはビア密度が高く、配線ピッチも小さなものもあります。次世代ゲーム機用パッケージは、それらも大きく上回るビア密度、配線ピッチとなっております。

このことはフリップチップパッケージがさらなる高度化が求められていることを意味します。

<スライド54：次世代ゲーム機市場の攻略>

次世代ゲーム機市場の攻略について述べます。

このグラフは現行ゲーム機と次世代ゲーム機の市場規模を予測したものです。

次世代ゲーム機は本年末から市場投入が始まり、2007年には現行ゲーム機を追い抜き、飛躍的に拡大するものと考えております。

私どもは高性能半導体の設計、製造およびパッケージングメーカーでありますIBM社を始め各社とは、設計や、様々な評価段階から共に取り組み、パッケージを開発して参りました。

この拡大市場の中でさらに各社との連携を図り、フリップチップパッケージの量産立ち上げに傾注し、事業の大きな柱にして参りたいと考えております。

<スライド55：デジタルエンタテインメント機器市場の動向>

これはデジタルエンタテインメント機器の台数ベースでの市場動向を予想したものです。

デジタルTV、DVDビデオレコーダー、STB、ゲーム機関連、いずれも大きく伸び、トータル台数では、今年は前年比で119%、さらにその後も120から130%と増大するものと予想しております。

これらの機器には高性能半導体が使用されるために、フリップチップパッケージの需要は確実に増大していくものと考えております。

<スライド56：生産拠点戦略>

KSTの生産拠点戦略としましては、6月20日に操業スタートいたしました京都綾部の新工場では、大量生産品の生産活動に特化し、鹿児島・野洲の既存の工場では、設計・技術開発・客先対応と多品種生産を主体に対応していく計画です。

<スライド57：京都綾部新工場の概要>

総敷地面積151,600平方メートル、建設面積8,400平方メートルの140m×60mの3階建てで、延床面積は25,200平方メートルとなっております。

当工場は、革新的な発想をもとに従来の製造プロセスを短縮し、最先端の生産設備、工場保全施設を有した生産ラインとなっております。

<スライド58：有機パッケージの今後>

有機パッケージの今後の展開について述べさせていただきます。

半導体チップの密度は今後も増加が予測されます。先ほども有機パッケージのビア密度が高くなってきていることをお話いたしましたでしたが、今後もさらなる密度増

加が必要となってくると考えております。

将来、現在のパッケージ製造技術では対応が難しくなるため、新規テクノロジーによる革新的な技術開発、未来のマーケットを創造していく取り組みが必要であります。

この課題解決には、

- ・マーケットニーズをより早くつかみ、マーケットに新規提案をしていくこと
- ・多くのユーザーと接し、方向性を見出すこと
- ・先の市場を読み、商品開発、生産技術開発を完璧に作り上げていくことだと考えます。

<スライド59：半導体バックエンド配線を取込める高密度配線>

これは、現状の半導体チップとパッケージの配線幅を表しております。

K S T 研究開発では、この両者の配線ルールのギャップを埋めることができる、高密度配線が可能な新パッケージとして、半導体チップの外層配線を取り込み、低い導通抵抗の配線で半導体の動作性能を上げる新規テクノロジーにより、未来マーケット創造を目指しております

<スライド60：京セラS L Cテクノロジー（株）の目標>

最後に、京セラS L Cテクノロジーは、「有機高密度配線基板の技術開発型専門メーカーとして、ユビキタスネットワーク社会の進歩発展」に、積極的に貢献していきたいと思っております。

そして、京都綾部の新工場、また、鹿児島・野洲の既存工場のライン増強を図りまして、飛躍的な生産容量の拡大を行います。そして京セラグループのさらなる成長・発展に貢献できるように積極的に取り組んでまいります。

以上